

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年8月25日(25.08.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/176182 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の
1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/006549

(22) 国際出願日: 2021年2月22日(22.02.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川 (SHINKAWA LTD.) [JP/
JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平2
丁目51番地の1 Tokyo (JP).

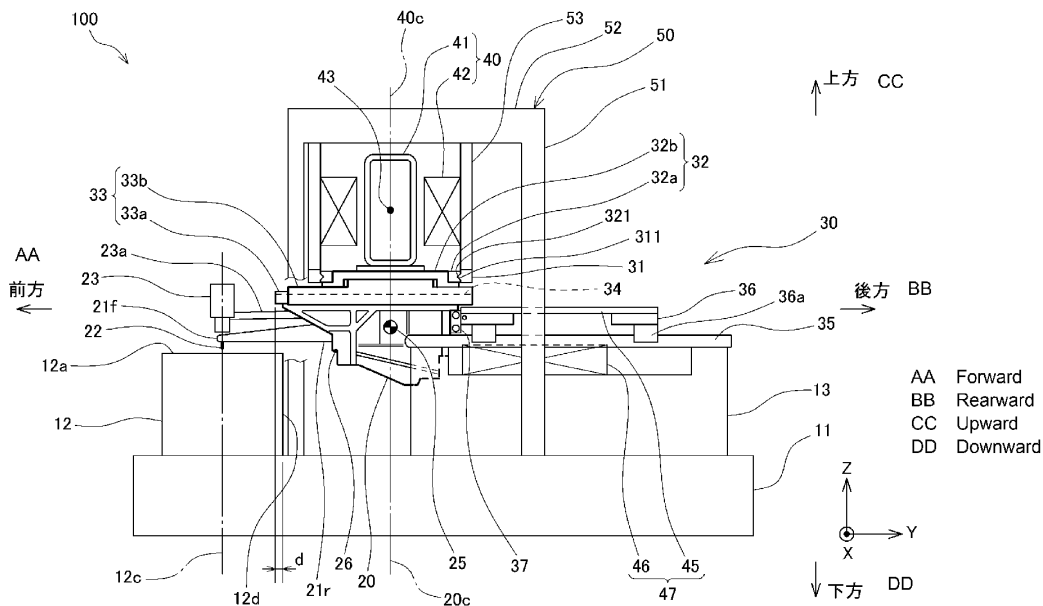
(72) 発明者: 角谷 修 (KAKUTANI, Osamu);
〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平2丁目
51番地の1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
早田 滋 (HAYATA, Shigeru); 〒2088585 東京

(74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特
許事務所 (YKI INTELLECTUAL PROPERTY
ATTORNEYS); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥
寺本町一丁目34番12号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: WIRE BONDING DEVICE

(54) 発明の名称: ワイヤボンディング装置



(57) Abstract: A wire bonding device (100) includes a bonding stage (12), a bonding head (20), an XY drive mechanism (30), and a frame (50), wherein: the XY drive mechanism (30) is provided with an X-direction guide (31) attached to the frame (50), an X-direction slider (32) which is supported by the X-direction guide (31) and moves in the X-direction, and to which an X-direction movable element (41) is attached, a Y-direction guide (33) attached to a lower side of the X-direction slider (32), and a Y-direction slider (34) which is supported by the Y-direction guide (33) and moves in the Y-direction, and to which the bonding head (20) is attached; and the XY drive mechanism (30) is attached to the frame

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(50) above a placement surface (12a) of the bonding stage (12) and rearward of the bonding stage (12) in the Y-direction, in such a way that a portion of the Y-direction guide (33) overlaps the placement surface (12a).

(57) 要約: ボンディングステージ (12) と、ボンディングヘッド (20) と、XY駆動機構 (30) と、フレーム (50) と、を含むワイヤボンディング装置 (100) であって、XY駆動機構 (30) は、フレーム (50) に取付けられるX方向ガイド (31) と、X方向ガイド (31) によって支持されると共にX方向に移動し、X方向可動子 (41) が取付けられるX方向スライダ (32) と、X方向スライダ (32) の下側に取付けられるY方向ガイド (33) と、Y方向ガイド (33) によって支持されると共にY方向に移動し、ボンディングヘッド (20) が取付けられるY方向スライダ (34) と、を備え、XY駆動機構 (30) は、ボンディングステージ (12) の載置面 (12a) よりも上方且つボンディングステージ (12) のY方向後方で、Y方向ガイド (33) の一部が載置面 (12a) に重なるようにフレーム (50) に取付けられている。